



芯原股份有限公司 2019 年校园招聘

公司简介:

芯原股份有限公司(芯原)是一家芯片设计平台即服务(Silicon Platform as a Service, SiPaaS™)提供商,为包含移动互联设备、数据中心、物联网(IoT)、可穿戴设备、智能家居和汽车电子等多种终端市场在内的各种广泛应用提供以 IP 为中心的、基于平台的芯片定制服务和一站式端到端的半导体设计服务。

芯原 SiPaaS 解决方案可缩短设计周期、提高产品质量和降低风险。宽泛和灵活的 SiPaaS 解决方案为包含新兴和成熟半导体厂商、原始设备制造商(OEMs)、原始设计制造商(ODMs),以及大型互联网平台 提供商在内的各种客户类型提供极具吸引力的半导体产品替代解决方案。芯原成立于 2001 年,其公司总部位于中国上海,目前在全球已有超过 600 名员工。芯原在中国、美国和芬兰共设有 6 个设计研发中心,并在全球共设有 9 个销售和客户支持办事处。

宣讲:

时间: 2018 年 9 月 5 日 14:00-17:00

地点: 东南大学(四牌楼校区)榴园宾馆逸夫科技馆一楼报告厅

请携带纸质简历, 宣讲后现场笔试。

- 14:00-15:30 公司介绍、职位介绍、校友分享
- 15:30-15:45 现场提问(有机会获得精美礼品一份)
- 15:45-17:00 笔试

需求岗位:

- 芯片系统设计/验证工程师(上海)
- 射频电路设计工程师(上海)
- 设计实现工程师(上海)
- DFT(可测性设计)工程师(上海)
- 基础 IP 电路设计工程师(上海)
- 版图设计工程师(合肥)
- 模拟电路设计工程师(上海/合肥)
- 系统应用工程师(上海)
- 嵌入式软件工程师(上海)
- 集成电路设计/验证工程师(上海)
- 软件工程师(上海)

公司主页:

www.verisilicon.com